行政院原子能委員會

委託研究計畫研究報告

太陽電池磊晶技術開發

The development technique of solar cell epitaxial

- 計畫編號:992001INER053
- 受委託機關(構):國立中央大學
- 計畫主持人: 綦振瀛
- 核研所聯絡人員:楊敏德
- 聯絡電話:03-4227151 ext.34541
- E-mail address : chyi@ee.ncu.edu.tw
- 報告日期: 99.12.10

摘要

計畫名稱:太陽電池磊晶技術開發

計畫編號:992001INER053

本計畫中我們利用分子束磊晶方式在硒化鋅上成長鎵摻雜之氧 化鋅(GZO)作為透明導電層以應用於多接面太陽電池。在適當的磊晶 條件下,可獲得最低的電阻率為 5.0×10⁻⁴ Ω-cm。此外,本實驗室首次 開發 Ti/Al/Ni/Au 歐姆金屬組合於 GZO 上,在 300 度退火處理後可獲 得接觸電阻率低至 2.6×10⁻⁷ Ω-cm²。

關鍵字:GZO, Ti/Al/Ni/Au, 接觸電阻

計畫主持人: 綦振瀛

參與人員:陳政佑、楊正宇

所屬單位:中央大學電機工程學系

Abstract

Ga-doped ZnO (GZO) transparent conductive layers have been grown on ZnSe/GaAs by molecular beam epitaxy for applications to InGaP/GaAs/Ge triple junction solar cells. Under optimized conditions, GZO films with resistivity as low as $5.0 \times 10^{-4} \Omega$ -cm have been obtained. Besides, Ti/Al/Ni/Au is used as the ohmic contact on GZO for the first time. Specific contact resistivity as low as $2.55 \times 10^{-7} \Omega$ -cm² has been achieved.

Keywords : GZO, Ti/Al/Ni/Au, contact resistivity

目 錄

壹、	背景說明		5
貳、	計畫緣起與E	目的	6
參、	研究方法與這	過程	8
肆、	實驗結果與言	寸論	11
伍、	結論		20
陸、	參考文獻		21
柒、	論文產出		22

壹、背景說明

氧化鋅及硒化鋅為目前廣泛被應用且製作光電元件的二六族材 料,將此兩種材料共通的二族元素"鋅"混合不同的比例的六族元素 形成三元的化合物,如硒化鋅中部分的硒被氧所取代形成氧硒化鋅化 合物,其能隙將會因為氧與硒的負電性與原子大小差異而產生能隙彎 曲的現象,效果猶如砷化鎵中加入氮所產生的能帶彎曲現象。成長硒 氧化鋅並藉由硒、氧比例的不同將能隙將含括紫外光調整到紅外光波 段,以目前技術,可將硒氧化鋅吸收範圍從藍光延續至黃綠光,若以 此材料成長於目前三層堆疊太陽能電池上,將可增加高能量的吸收區, 減少聲子的產生,降低熱效應對材料的影響,同時利用硒氧化鋅的高 能隙增加開路電壓以提高光電轉換效率。

貳、計畫緣起與目的

現階段大多數發展多層接面太陽能電池以 InGaP/(In)GaAs/Ge 結 構為大宗,其能隙分別為 1.86 eV、1.43 eV、0.65 eV,此結構可有效 改善單一接面的吸收效率且其光電轉換效率為 30%以上,目前最利用 聚光型式轉換效率可達 40% 以上[1]。為了達到更高的轉換效率,四 層堆疊以上的太陽能電池尚有提升太陽能電池效率的空間,而先前被 提出來的四層堆疊太陽能電池是以氮砷化鎵材料,能隙約為 1eV 左右, 成長於鍺和砷化鎵之間,但該材料的缺陷造成載子的擴散長度下降, 因此並沒有大幅提升太陽能電池效率。

目前的多層堆疊太陽能電池最上層為磷化銦鎵,能隙約為 1.86 eV 左右,當能量大於 1.86 eV 的光子由材料吸收後將以熱的形式把多餘 的能量釋放,因而影響太陽能電池的光電轉換效率,因此於磷化銦鎵 上成長一較高能隙的材料,可增加可見光範圍的吸收範圍,此四層堆 疊太陽能電池吸收光譜將大於現今一般的三層堆疊太陽能電池,且較 高能隙材料也將可望提升太陽能電池開路電壓,藉此大幅提升太陽能 電池的效率。曾有一研究團隊提出一緒/砷化鎵/硒化鋅的三層堆疊太 陽能電池結構,宣稱此結構可涵蓋 94 %的太陽光譜並藉由理論計算 得到 56 %的轉換效率 [2]。

目前本實驗室擁有成長硒化鋅與氧硒化鋅的技術,利用硒化鋅高

6

能隙與直接能隙的特性,且氧硒化鋅可藉由硒、氧比例的不同可將能 隙從 2.8eV 調整至 2.2 eV。此外,硒化鋅晶格常數與砷化鎵也相當匹 配,如圖一所示,因此將氧硒化鋅材料成長於三層堆疊太陽能電池上, 形成四層堆疊太陽能電池,可增加涵蓋太陽光光譜的效率。此四層堆 疊太陽能電池將吸收從紫外延續到紅外光的能量,不同材料對於光譜 吸收涵蓋圖。由於本實驗室同時擁有氧化鋅透明導電層的成長技術, 因此於硒化鋅成長後,在相同反應腔體中繼續於其上成長氧化鋅透明 導電層,藉此增加太陽光吸收面積,以提升太陽能電池的效率。因此 本實驗室目前將以製作 N 型與 P 型硒化鋅為目標。

參、研究方法與過程

一、磊晶系統

我們利用 RIBER Compact-12 電漿輔助分子束磊晶系統 (plasma-assisted molecular beam epitaxy)成長試片,目前實驗室有兩個 分子束源(effusion cell)與一個高周波電漿源(Ratio-Frequency plasma source, RF-plasma source),分子束源分別為 6N 鋅(Zn)、6N 硒(Se), 藉由電阻加熱的方式來控制蒸鍍源的溫度,調整蒸鍍材料的流量。電 漿源則通入經由過濾器及純化器過濾之 6N 氧氣(O),利用高周波激發 氧形成活氧原子,腔體內活氧原子流量則藉由流量控制器(mass flow controller, MFC)調整氧氣流量。長晶過程中,利用反射式高能電子 繞射(reflection high energy electron diffraction, RHEED),觀察晶格表 面的繞射圖案,用來監控長晶時的晶體表面型態。

二、量測系統

材料分析方面,我們利用下列的分析儀器來分析成長出來的品 質:

(一) x-ray 繞射儀(XRD):利用 x-ray 繞射測試可以很清楚地了解成長 之晶體組成及其間晶格匹配的情形,並進而改變成長 參數以獲得所預 期之材料。

(二)光激發螢光量測(PL measurement): 在所成長之晶膜材 料可利用光

8

激發螢光量測觀察材料之波長,進而求得其相對應之能隙,並進而改 變成長參數以獲得所預期之材料。

(三)霍爾量測(Hall measurement):量測試片的極性、載子遷移率和載 子濃度。

三、試片製備

(-) GZO on ZnSe

在 SI-GaAs 基板上先成長 300 nm 未掺雜硒化鋅,在於其上成長 一鎵掺雜之氧化鋅,磊晶結構如圖一所示,其中包含一片未掺雜鎵的 氧化鋅做為參考試片。磊晶條件如表一所示,試片 245 至 247 為固定 氧氣流量與成長溫度,僅改變鋅的溫度,而試片 249 則是將 300 度成 長下特性最佳的條件再升至 350 度成長,藉由高溫的成長希望提升材 料的品質。



圖一、GZO 磊晶結構圖

Samples	Growth condition	T _s	Time
	Zn:370/520	300 °C	30'
un-doped ZnO	O:0.2 sccm		
	RF:350W		
	Zn:350/500	300 °C	30'
245	O:0.2 sccm		
-245-	RF:350W		
	Ga:420		
	Zn:360/510	300 °C	30'
246	O:0.2 sccm		
-240-	RF:350W		
	Ga:420		
	Zn:370/520	300 °C	30'
247	O:0.3 sccm		
-2-+/-	RF:350W		
	Ga:450		
	Zn:370/520	350 °C	30'
240	O:0.2 sccm		
-247-	RF:350W		
	Ga:420		

表一、GZO 磊晶條件

(ニ) Contact on GZO

為了在掺雜鎵之氧化鋅(ZnO:Ga;GZO)上製作良好的歐姆接觸, 我們首用 n 型 GaN 歐姆接觸的金屬 Ti/Al/Ni/Au 做為 GZO 的歐姆金 屬。利用電子槍蒸鍍系統蒸鍍 Ti(250Å)/Al(1250Å)/Ni(450Å)/Au(550Å) 合金並製作 TLM 模型來量測接觸電阻,並以四點探針進行 I-V 量測 的部分,依據下列公式計算出特徵接觸電阻(contact resistivity, ρ_c)及 半導體的片電阻值(sheet resistance, R_{Sh}):

$$R = 2R_{C} + \rho_{S} \frac{d}{W \times t} = 2R_{C} + \left(\frac{R_{Sh}}{W}\right) \times d$$
(1.1)

$$R_{Sh} = m \times W = \frac{R_C W}{L_T}$$
(1.2)

$$\rho_{\rm C} = R_{\rm C} W L_{\rm T} = L_{\rm T}^2 R_{\rm Sh} \tag{1.3}$$

其中 R_c為金屬/半導體接面電阻,ρ_s為半導體的導電率,d 為鄰 近兩金屬電極的距離,W 為電極寬度,t 為材料厚度。蒸鍍完金屬 接觸之後,利用快速熱退火(RTA)分別在氮氟環境之中以300、400、 500 度退火一分鐘,並且觀察不同退火時間之下與接觸電阻與片電阻 之間的關係。

肆、實驗結果與討論

- \ GZO on ZnSe

1. 霍爾量測

各試片的霍爾量測結果列於表二,由表二可以觀察到,當氧化鋅 在未掺雜的情況下,載子濃度僅有 5.4×10¹⁷ cm⁻³,且載子遷移率也相 當低,因此阻值非常高,所以未掺雜的氧化鋅並不適合應用於透明導 電層。當鎵掺雜後,載子濃度即提升到 10¹⁸ 等級以上,進一步藉由調 變鋅蒸鍍源溫度,可以很觀察到隨著鋅的流量上升,材料載子濃度也 從原先的 10¹⁸ 次方提升到 10²⁰ 次方,而載子遷移率也維持在大約 10 cm²/V-s,因此氧化鋅片電阻由 1174 Ω/□降至 87 Ω/□。而將長晶溫度 提高,量測結果顯示,載子遷移率提高了兩倍,表示材料中電子的散 射機率下降,同時可以發現載子濃度也有大概 1.5 倍的提升,因此可 以得到最佳的電阻率約 5.0×10⁴ Ω-cm,在 150 nm 時僅有 36 Ω/□左右 的片電阻,對於應用在透明導電層來說是相當良好的特性。

Sample	N	μ	ρ	R _{sheet}	T_g
	(cm^{-3})	$(cm^2/V-s)$	(Ω-cm)	<i>(Ω/</i> □)	(°C)
un-doped	5.4×10 ¹⁷	0.68	17	853700	300
245(Zn:350)	3.1×10 ¹⁹	8.6	2.35×10 ⁻²	1174	300
246(Zn:360)	8.5×10 ¹⁹	9.0	8.10×10 ⁻³	405	300
247(Zn:370)	3.5×10 ²⁰	13.6	1.31×10 ⁻³	87	300

表二、GZO 霍爾量測結果

2. x-ray 繞射量測

為了確認材料的磊晶品質,我們以低掠角繞射 2-Theta 量測,結 果如圖三所示,其中紅色箭頭標示的角度為鋁板材料的繞射訊號,排 除鋁板的訊號之後,可以發現氧化鋅為多晶結構,由試片 245 可以觀 察到材料中包含了 ZnO(1-101)、ZnO(1-103)、Ga₂O₃(411)及 Ga₂O₃(321) 等多晶的訊號,隨著鋅溫度的上升,同時也出現了 ZnO(0002)的訊號, 當鋅的流量持續增加時,將會使鎵和氧鍵結的方式改變,因此 Ga₂O₃ 的訊號在較高的鋅流量環境之中會漸漸消失。而試片 249 在提高成長 溫度下,繞射圖形中僅有 ZnO(1-101)單一個相可以被觀察到,所以降 低材料中不同相造成的邊界散射機制,才能大幅提升載子遷移率約兩 倍。





圖三、GZO 試片 2-Theta 繞射量測繞射圖形

3. 光激發光譜量測

在室溫光激發光譜中,如圖四所示,幾乎沒有氧化鋅近能隙的發光,光譜主要由 defect-related 的發光所主導,而且文獻之中指出 defect-related 的發光主要原因有可能為氧空缺(V₀)和鎵間隙 (Ga-interstitial),在我們的試片中,可以觀察到經由鋅流量的上升,

defect-related 的發光強度大大地降低,推測由於鋅原子變多時,鎵有 更高的機會去取代鎵的位置,而有較少的 Ga interstitial 存在,因此 defect-related 的發光強度大大地降低。 另外由 247 及 249 來看,249 的基板溫度較高,由於 Zn-O bond 的 formation energy 大於 Ga-O bond 的 formation energy,當基板溫度升高時,會有較多的 Zn-O bond 形成, 表示較少的 Ga 去取代 Zn 的位置,因此 defect-related 的發光強度略 為提高。



圖四、GZO 室溫光激發光譜

4. SEM 量測



圖五、GZO 表面 SEM 圖

由 SEM 觀察,239-246 皆為 3D 形式的表面,常出現於多晶的 GZO 結構之上,當鋅流量持續上升時,表面轉於平坦,但有黑紋及一些白 色顆粒,基板升溫後,表面又轉為不平坦,目前還無法完整解釋這個 現象因此還需要再做進一步的探討。

ニ、 Contact on GZO

1. TLM 量測與 SEM 量測

將不同溫度退火後的金屬進行TLM量測,量測結果如表三所示, 根據以往的研究顯示[7],對材料進行退火時,Ti與擴散至Ti的Oxygen 會形成 TiO₂,此氧化物導電性非常好,此外,GZO 當中由於 Oxygen 擴散至 Ti,使得 GZO 當中形成氧空缺,過去的文獻解釋此氧空缺為 一種 donor-like defect[8,9],因此使得表面的載子濃度較為提升,改善 了接觸電阻。但當退火溫度超過 300°C 時,AI 會擴散至表面,並且 形成 AI-O 的氧化物[10],由於此氧化物導電性不佳,因此造成 contact resistivity 有所上升,從下圖中 SEM 也可明顯發現金屬表面有生成物 形成,SEM 的結果如下圖所示:

Annealing temperature	Sheet resistance	Contact resistivity
(^{o}C)	(Ω/\Box)	$(\Omega$ -cm ²)
Non-annealing	94	2.65×10 ⁻⁷
300	84	2.55×10 ⁻⁷
400	60	9.00×10 ⁻⁷
500	50	3.79×10 ⁻⁶

表三、TLM 量測結果(GZO with 150 nm)





圖六、不同退火溫溫度下金屬表面 SEM 圖



圖七、退火溫度對應片電阻與接觸電阻

2. 霍爾量測

此外,由霍爾量測的結果也顯示出退火之後 sheet resistance 有下降的情況,值得一提的是,此下降的趨勢與 TLM 所量測出來的趨勢 是相同的。從霍爾的結果也顯示退火之後載子遷移率有所上升,由此 可知, sheet resistance 會改善的原因主要歸因於 GZO 晶體品質的改

	un-annealed	500 °C annealed
Sheet Resistance (Ω/\Box)	91	58
Resistivity (Ω-cm)	1.37×10 ⁻³	8.69×10 ⁻⁴
Mobility (cm ² /V-s)	19.3	39.2
Concentration (cm ⁻³)	2.37×10^{20}	1.83×10^{20}

表四、Hall 量測結果

善。

伍、結論

本計畫中,我們以分子束磊晶成長方式在硒化鋅上成長 GZO,藉 由調整鋅和氧的比例成功成長出厚度 150 nm 時,電阻率僅為 5.0×10^{-4} Ω -cm,片電阻僅為 36 Ω / \Box 的 GZO 透明導電層。此外,我們首次使用 Ti/Al/Ni/Au 金屬組合作為 GZO 之歐姆接觸,在 300 度退火後可得到 低至 $2.55 \times 10^{-7} \Omega$ -cm²的最佳接觸電阻率。

陸、參考文獻

[1] R. R. King *et al.*, "40% efficient metamorphic GaInP/GaInAs/Ge multijunction solar cells", Appl. Phys. Lett. 90, 183516 (2007).

[2] Aikun Wang *et al.*, "ZnSe/GaAs/Ge triple junction solar cell and its structure design", J. Mater. Sci. Technol. Vol.20 No.5, (2004).

[3] Ralf Schwarz *et al.*, "Ohmic contacts to p-ZnSe using Pd metallization", Solid-state electronics 42, 139 (1998).

[4] V. N. Jmerik *et al.* "Electrically stable p-type doping of ZnSe grown by molecular beam epitaxy with different nitrogen activators", J. Cryst. Growth 214/215, 502 (2000).

[5] R. M. Park *et al.*, "p-ZnSe by nitrogen atom beam doping during molecular beam epitaxial growth", Appl. Phys. Lett. 57, 2127 (1990).

[6] J. Qiu *et al.*, "Heavily doped p-ZnSe:N grown by molecular beam epitaxy", Appl. Phys. Lett. 59, 2992 (1991).

[7] Han-Ki Kim et al., "Electrical and Structural Properties of Ti/Au Ohmic Contacts to n-ZnO", Journal of The Electrochemical Society 148 (3) G114-G117 (2001).

[8] K.Vanheusden et al., "Correlation between photoluminescence and oxygen vacancies in ZnO phosphors", Appl. Phys. Lett. 68, 403 (1996).

[9] T. Yamamoto et al., "Solution Using a Codoping Method to Unipolarity for the Fabrication of p-Type ZnO", Jpn. J. Appl. Phys. 38, L166 (1999).

[10] K. lp et al., "Carrier concentration dependence of Ti/Al/Pt/Au contact resistance on n-type ZnO", Appl. Phys. Lett. 84, 544, 2003

柒、論文產出

Journal paper :

 Kasimayan Uma, Cheng-Yu Chen, Chih-Kang Chao, Chih-Hung Wu, and Jen-Inn Chyi, "Spectroscopic ellipsometric analysis of ZnSe_{1-x}O_x layers with different O compositions", J. Appl. Phys., 108, 103113 (2010)

Conference paper :

- 1. Cheng-Yu Chen, Jen-Inn Chyi, Wen-Yen Chen, Tzu-Min Hsu, "Carrier dynamics in ZnSeO grown on GaAs by molecular beam epitaxy", MBE2010, Berlin.
- Cheng-Yu Chen, Jen-Inn Chyi, Wen-Yen Chen, Tzu-Min Hsu, Chih-Kang Chao, and Chih-Hung Wu, "Carrier Dynamics in ZnSeO Films Grown on GaAs by Molecular Beam Epitaxy", IEDMS2010, Jhongli..
- Kasimayan Uma, Cheng-Yu Chen, Chih-Kang Chao, Chih-Hung Wu, and Jen-Inn Chyi, "Observation of New Critical Points in ZnSe_{1-x}O_x Layers Using Spectroscopic Ellipsometry", IEDMS2010, Jhongli.
- 4. Li-Han Siao, Cheng-Yu Chen, and Jen-Inn Chyi, Chih-Kang Chao, and Chih-Hung Wu, "Properties of In-doped ZnO grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy on GaN(0001) templates", OPT2010, Tainan.
- 5. Cheng-Yu Chen, Li-Han Siao, and Jen-Inn Chyi, Chih-Kang Chao, and Chih-Hung Wu, "Electrical properties of In-doped ZnO films grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy on GaN(0001) template", OPTO2011, San Francisco.